证券代码：603061　　证券简称：金海通　　公告编号：2026-083

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于部分募投项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次拟结项的募投项目名称：天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年首次公开发行股份募投项目之一“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”。
- 募集资金使用情况：上述项目已达到预定可使用状态，已满足结项条件且募集资金已使用完毕，结项后无节余资金。
- 审议程序：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本次募投项目结项无需提交董事会审议，亦无需保荐机构发表意见。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]83号文《关于核准天津金海通半导体设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2023年2月公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股发行价为人民币58.58元，募集资金总额为人民币878,700,000.00元，根据有关规定扣除发行费用131,888,125.09元（不含税）后，募集资金净额为746,811,874.91元，该募集资金已于2023年2月24日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]361Z0008号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金总额	87,870.00 万元
募集资金净额	74,681.19 万元
募集资金到账时间	2023 年 2 月 24 日

二、募投项目的基本情况

单位：万元　币种：人民币

序号	原承诺投资项目名称	原承诺投资总额	调整后承诺投资项目名称	调整后拟投资总额	是否结项
1	半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	43,615.04	不适用	不适用	本次结项
2	年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目	11,066.15	购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目	2,300.00	实施中
3			补充流动资金	1,170.52	不适用
4	补充流动资金	20,000.00	不适用	不适用	不适用

注 1：公司终止募投项目“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”，并将剩余募集资金 3,205.05 万元继续存放募集资金专户管理，公司将积极筹划寻找新的投资项目或审慎研究判断现有项目是否追加投资。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》（公告编号：2025-024）以及于 2025 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

注 2：公司使用终止募投项目“年产 1,000 台（套）半导体测试分选机机械零配件及组件项目”剩余募集资金（含理财收益及利息扣除手续费支出等）中的 2,300 万元实施全资子公司 JHT SEMICONDUCTOR SDN. BHD.（马来西亚槟城金海通）的“购置马来西亚生产运营中心现有租赁厂房项目”，并将剩余募集资金 1,170.52 万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-065）以及于 2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-070）。

三、本次结项募投项目的相关情况

公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次

会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”的内部投资结构，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-045）。

截至2026年10月，公司2023年首次公开发行股份募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目” 已达到预定可使用状态，已满足结项条件且募集资金已使用完毕，结项后无节余资金。具体情况如下：

单位：万元　币种：人民币

募投项目名称	承诺投资总额(A)	累计利息(B)	募投项目累计投入金额(C)	募集资金专户余额(D=A+B-C)	募投项目应付未付金额
半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目	43,615.04	1,821.14	38,936.01	6,500.17	6,500.17

注：“募投项目应付未付金额”为需支付但未达到支付条件的项目建设未结算增补款项及尾款、设备款等，募投项目应付未付金额最终以工程结算后数据为准。

本次“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”结项后，考虑到该项目尚有需支付但未达到支付条件的项目建设未结算增补款项及尾款、设备款等，为更合理地使用募集资金，公司后续将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件及公司规范运作制度的要求，继续对募集资金进行专户管理。待支付款项全部结清后，公司将按照相关要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议将随之终止。

四、适用的审议程序

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万或低于该募投项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会审议程序，无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确意见。因此，本次募投项目结项事宜无需董事会审议，亦无需保荐机构发表核查意见。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日